

第十九届中国覆铜板技术研讨会

邀请书

“第十九届中国覆铜板技术研讨会”定于 2018 年 10 月 25 日至 10 月 27 日在江苏省昆山市“昆山瑞豪大酒店”召开。

在迅速发展的 5G、汽车电子、消费电子产品等市场需求的驱动下，我国覆铜板在当前实现高频、高速、高导热、高可靠性等进程中，制造技术水平得到快速发展。我国覆铜板业正在面临着众多产品换代升级、新技术革命性突破；国际贸易摩擦升级需要我们为 PCB 全面配套基板材料而加快国产化步伐。当前，中国覆铜板及其原材料业又有了哪些市场需求新热点及新趋势、产品及技术开发有了哪些新成果？中国电子材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子电路行业协会基板材料分会定于 2018 年 10 月 25 日至 10 月 27 日在江苏省昆山市“昆山瑞豪大酒店”组织召开“第十九届中国覆铜板技术研讨会”。在此大会召开期间，设立分会场同时举行“第五届中国挠性覆铜板企业联谊会”。

本届研讨会的主题是“迎接自主创新的机遇与挑战”。大会将邀请覆铜板业及其上下游的业界专家作精彩报告。还有来自国内覆铜板行业及其上下游行业的专家、技术人员撰写的优秀论文，对覆铜板制造的新技术、新工艺、新材料、新设备、新标准及未来覆铜板市场、技术的发展趋势，进行深入广泛的研讨。并在大会召开之际，颁发本届研讨会的“CCLA 杯优秀论文奖”。

热忱欢迎海内外覆铜板及上下游企业代表、业界人士届时光临。

主办单位及联络资讯：

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA） 王晓艳 029-33335234

中国电子电路行业协会基板材料分会（CPCA） 李琼 021-54179011-605

协办单位：

诺德投资股份有限公司

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）

中国电子材料行业协会电子精细化工与高分子材料分会（ECMA）

广东省线路板行业协会（GPCA）

深圳市线路板行业协会（SPCA）

台湾电路板协会（TPCA）

宣传媒体：

杂志：《覆铜板资讯》、《电子铜箔资讯》、《印制电路资讯》、《PCB007 中国线上杂志》。

网站：中国覆铜板信息网 www.chinaccl.cn；中国电子铜箔资讯网 www.chinaccf.com.cn；ECMA 网 www.ecma.org.cn；PCB 网城 www.pcbcity.com.cn。

赞助单位：（征集中）

南亚新材料科技股份有限公司

山东圣泉新材料股份有限公司

苏州巨峰新材料科技有限公司

广东生益科技股份有限公司

广东同宇新材料有限公司

南通凯迪自动机械有限公司

江苏瀚高科技有限公司

成都科宜高分子科技有限公司

南通图海机械有限公司

四川东材科技集团股份有限公司

德国申克博士测试设备有限公司

安徽大松树脂有限公司

江苏泰氟隆科技有限公司

会议日程：（附后）

《第十九届中国覆铜板技术研讨会》：2018年10月25日~27日。25日全天报到，26日（8:20~18:00）全天报告，27日疏散。

《第五届中国挠性覆铜板企业联谊会》：2018年10月26日（13:30~18:00）。

会议费用：

费用包括：会务费、资料费、餐饮费等。会员单位代表：已交会员费单位收1300元/人（未交会员费的单位1500元/人）；非会员单位代表1800元/人。参会代表可提前将会务费用汇至协会账户，如参会人员有变动，可随后退费或报到现场补交。

住宿：参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间：标间：418元/晚/间（含双早）；单间338元/晚/间（含单早），预定住宿联系人：李双伟 18915737022，费用自理。

付款方式:

帐 户:中国电子材料行业协会

开户银行:工行北京香河园支行

帐 号: 0200 0191 0900 0125 724

注: 提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组, 收到汇款后即可开票邮寄, 汇款时请附言“覆铜板会议会务费”, 以便区分; 现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组, 以便会议报到时及时开票。

会 址: 昆山瑞豪酒店 (江苏省昆山市震川东路与黄浦江路交叉口)

电话: 0512-55189999

会议酒店交通指南:

1、**飞机:** 上海浦东机场、上海虹桥机场, 均有机场大巴到昆山航站楼, 昆山航站楼距离昆山瑞豪酒店 1000 米, 可步行亦可打出租至酒店。

上海浦东国际机场、上海虹桥机场至昆山航站楼巴士时刻表

	浦东机场、虹桥机场到昆山航站楼发车时间表						
浦东机场—昆山航站楼	9:00	10:30	11:30	12:30	13:30	14:30	15:30
	16:20	17:10	18:10	19:00	20:00	20:45	
虹桥机场—昆山航站楼	10:15	13:46	15:41	16:40	18: 21	19:21	21:10

2、**高铁: 昆山南站:** 昆山南站距离会议酒店约 9.6 公里, 可乘出租至酒店, 参考费用约 28 元左右。或乘 17 路公交 (从中大柏庐天下上车至军泽园下车), 然后步行 300 米左右至酒店。

3、**自驾车:** 从陆家高速西出口下高速, 距离酒店最近, 大概 12 公里左右, 20 分钟左右即可到达酒店。

会务组联络方式:

联系人: 王晓艳 13609146084 , 029-33335234 , 13369111960

传 真: 029-33335234

E-mail: ccla33335234@163.com

《第十九届中国覆铜板技术研讨会》组委会

2018 年 10 月 9 日

《第十九届中国覆铜板技术研讨会》 会议回执

单位名称					订房数量	
代表姓名	职务	手机	电话	E-mail	单人间	双人间
开票信息：名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号：						
注意	1、房源有限，计划在昆山瑞豪酒店住宿的代表，务请于2018年10月20日前自行与酒店联系预订房间！联系时请报“覆铜板行业协会会议”，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人：李双伟 18915737022。 2、请参会代表准确填写回执表各项信息，将回执于10月23日前发至 ccl1a33335234@163.com 。了解研讨会最新动态请登录： www.chinaccl.cn ，或者直接联系会务组。					

10月26日会议日程表

时间	报告地点、报告人及报告题目	主持人
三楼 《宴会厅》		
8:20 ~ 12:00	CCLA 理事长 张东：致开幕词	祝大同
	CPCA 领导致词	
	诺德投资股份有限公司常务副总裁 陈郁弼 致欢迎词	
	颁发 2018 年“CCLA 杯”优秀论文奖（获奖人员合影留念）	
	中国电子科技集团公司第 14 研究所研究员级高级工程师 杨维生： 当前高频微波电路基板材料的技术新进展及其开发热点的分析	
	诺德投资股份惠州联合铜箔电子材料有限公司总经理 周启伦： 厚铜箔在汽车 PCB 应用及其性能提升的研究与开发	
	广州杰赛科技股份有限公司研发经理 李超谋： 当前微波印制板对基板材料性能要求	
	国家电子电路基材工程技术研究中心、广东生益科技股份有限公司高级工程师 苏民社： PTFE/陶瓷填充覆铜板的制备及性能	
	麦可罗泰克(常州)产品服务有限公司董事长 Robert Edward Neves（鲍勃） IPC-4101 测试和验证服务要求	
江苏联瑞新材料股份有限公司副总经理 曹家凯： 覆铜板用填料现状与趋势		
12:00~ 13:30	自助午餐（一楼西餐厅）	王晓艳
三楼 《宴会厅》		
13:30~ 18:00	佛山市英斯派克自动化工程有限公司总经理 章敬文： 打造覆铜板外观智能检测装备 助力覆铜板智能制造升级	师剑英
	诺德投资股份江苏联鑫电子工业有限公司副总经理 汪小琦： 浅谈外来杂质及介质层缺陷对铝基覆铜板耐高压性能的影响	
	国家电子电路基材工程技术研究中心、广东生益科技股份有限公司研发工程师 罗成： 含磷酚醛在无卤 low loss 覆铜板的运用研究	
	西安交通大学软件学院研究生 焦梓煜：一体化微波电性能测试系统	
	南亚新材料科技股份有限公司技术部经理 粟俊华： IC 封装用基板材料的研究与性能	
	国家电子电路基材工程技术研究中心、广东生益科技股份有限公司研发工程师 黄增彪： 4W 高导热铝基板的研究与制备	
	苏州生益科技有限公司研发工程师 戴善凯： 固化促进剂对环氧树脂体系流变特性及覆铜板厚度控制的影响	
	陕西生益科技有限公司总工程师 师剑英： 浅析封装基板的设计开发	
18:30~ 20:30	诺德投资股份有限公司 招待晚宴 《二楼 江南小厨》	何思敏 王晓艳

《第五届中国挠性覆铜板企业联谊会》暨《CCL 用材料报告会》日程及报告安排

时间	报告地点、报告人及报告题目	主持人
二楼 《夏荷厅》		
10月26 日下午 13:30 ~ 15:30	中国科学院长春应用化学研究所博士 郭海泉： 高性能聚酰亚胺薄膜的市场需求与技术挑战	
	国家电子电路基材工程技术中心、广东生益科技有限公司研发工程师 汪青： 一种高 Tg 胶膜的配方开发及其应用技术研究	
	华烁科技股份有限公司副研究员 严辉： 水性软硬结合板胶膜的制备研究	
	CCLA 副秘书长 祝大同：对 PCB 用树脂膜新技术与新市场的探讨	
休 息		
15:40 ~ 18:00	中国电子学会电子制造与封装技术分会印制电路专委会 顾问 辜信实： 含磷酚醛树脂开发与应用	祝大同
	华烁科技股份有限公司总经理助理 徐庆玉： 面向高频电子通信领域应用的苯并噁嗪树脂研究进展	
	四川东材科技集团股份有限公司、国家绝缘材料工程技术研究中心博士 周友： 低介电双马来酰亚胺树脂的合成及性能研究	
	山东圣泉新材料股份有限公司研发经理 葛成利： 新型增韧型含磷环氧树脂的制备及其在覆铜板中的应用	
	四川东材科技集团股份有限公司、国家绝缘材料工程技术研究中心高级工程师 叶伦学： 一种新型低羟基含磷环氧的合成及性能研究	
18:30 ~ 20:30	诺德投资股份有限公司 招待晚宴 《二楼 江南小厨》	何思敏 王晓艳

会期日程：

2018年10月25日~27日。25日全天报到，26日全天报告，27日疏散。